合肥颀中科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"颀中科技"、"发行人"、"公司"或"本公司")股票将于2023年4月20日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书中所引用数据,如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与原始数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

2023年4月13日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年年度审计报告的议案》和《关于公司2023年第一季度财务报告的议案》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表及相关财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2023]4837号)。公司2023年第一季度财务报表未经审计。(2022年完整审计报告和2023年第一季度财务报表请参见本上市公告书附件,上市后不再单独披露2022年度报告和2023年一季度报告)。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为118,903.7288万股,上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,参与战略配售的其他战略投资者本次获配股票的限售期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为15,132.9051万股,占发行后总股本的比例为12.73%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2023年4月3日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为30.30倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应2021年的静态市盈率(扣非前)	对应2021年的静态市盈率(扣非后)
002156.SZ	通富微电	0.6322	0.5262	22.77	36.02	43.28
603005.SH	晶方科技	0.8819	0.7215	25.54	28.96	35.40
688135.SH	利扬芯片	0.7712	0.6679	35.67	46.25	53.41
688216.SH	气派科技	1.2665	1.1894	31.35	24.75	26.36
688403.SH	汇成股份	0.1681	0.1125	13.95	83.00	123.99
均值					43.80	56.49

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年4月3日(T-3日)。

注1:2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年4月3日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格12.10元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为50.37倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2021年扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书"第四节风险因素"章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素(以下"报告期"指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月):

(一)业绩增长不能持续或业绩下滑的风险

2022年以来,我国经济发展面临的外部环境复杂性和不确定性加剧,特别是俄乌地缘政治冲突导致全球经济通胀风险加剧及全球终端消费力减弱。而高通胀下美联储加息步伐加快,更使得全球经济复苏放缓。同时,智能手机、高清电视等终端应用市场需求下降,显示面板需求及市场价格有所回落。2022年1-6月,虽然公司主营业务收入同比增长21.28%,但较2021年同比增速有所下降,若未来外部环境和市场供求关系无法改善甚至进一步恶化,将导致公司主要产品的收入或毛利率下滑,从而对公司整体业绩造成不利影响。同时,随着显示驱动芯片从8吋向12吋转移的趋势不断加快,若公司相关客户的验证和导入不及预期,也将对公司业绩产生负面影响。因此,公司可能存在未来业绩增长不能持续或业绩下滑的风险。

(二)市场竞争加剧的风险

近年来,全球各大封测厂商均积极布局先进封装业务。在显示驱动芯片封测领域,除细分行业境外龙头颀邦科技、南茂科技继续在相关领域保持领先地位外,境内封测厂商也不断加大相关领域的投入。例如,通富微电通过参股公司厦门通富微电子有限公司在显示驱动芯片封测领域的布局不断深入,相关规模持续增长;汇成股份于2022年8月通过首次公开发行股票充实了资金实力,并运用募集资金投资"12吋显示驱动芯片封测扩能项目"以提升产能;此外,深圳同兴达科技股份有限公司也宣布与日月光将在金凸块全流程封装测试领域开展合作。

虽然公司最近三年显示驱动芯片封测收入均位列中国境内第一,但相较于境外头部封测企业,公司在资产规模、资本实力、产品服务范围等方面存在一定差距。同时,面对境内市场竞争加剧的局面,若公司不能较好地采取措施应对,可能会对公司业务开拓以及未来经营业绩产生不利影响。

(三)商誉减值风险

2018年1月,公司收购苏州颀中形成商誉88,748.48万元。报告期各期末,公司对商誉进行了减值测试,经测试核心商誉不存在减值迹象,故未计提减值准备。报告期内,苏州颀中系公司封装测试业务主要经营主体,如果未来封装测试市场需求下滑,产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化,而苏州颀中未能适应前述变化,则可能对苏州颀中的盈利能力产生不利影响,进而可能使公司面临商誉减值的风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。

(四)非显示类业务拓展不利的风险

发行人于2015年开始布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等非显示先进封装技术的研发,并于2019年完成后段DPS封装的建置。一方面,公司非显示类业务虽增长较快但整体规模仍相对较小,且主要以8吋非全制程产品为主;另一方面,公司非显示业务主要集中在电源管理、射频前端等芯片领域,大部分客户来自中国境内,与长电科技、通富微电、华天科技等头部综合类封测企业相比竞争力尚有较大差距。

若综合类封测企业对相关细分领域进行大规模投入、非显示类客户导入不及预期、下游终端市场环境出现不利变化,或短期内公司无法丰富非显示封测业务的产品种类,则可能存在相关业务拓展不利的风险。

(五)客户集中度较高的风险

报告期内,发行人对前五大客户的收入合计分别为60,402.33万元、71,242.39万元、84,738.95万元和38,949.57万元,占营业收入的比例分别为90.25%、82.01%、64.18%和54.37%,虽然占比逐年降低,但客户集中度依然较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化,或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降,且公司未能及时拓展新客户,则公司可能存在收入增速放缓甚至下降的风险。

(六)贸易摩擦及区域贸易政策变化导致的风险

报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比例分别为86.49%、83.83%、66.85%和55.40%,占比较高,并以中国台湾地区客户为主。同时,公司部分原材料(如光阻液、Tray盘等)和生产设备(如测试机、探针台、晶圆切割机、内引脚接合机等)采购自境外,以日本、韩国供应商为主,中国大陆替代供应商相对较少。

近年来,国际贸易环境不确定性增加,在集成电路领域,美国修订《瓦森纳协定》加强半导体出口管制,并将多家中国技术领先型企业和机构列入美国出口管制的"实体清单",还陆续出台《芯片和科学法案》《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》等措施对华先进制程的芯片技术进行出口管制。

虽然上述贸易政策及出口管制措施对公司现有业务影响有限,但如果未来相关国家或地区与中国大陆的贸易摩擦持续升级,并通过贸易政策、关税、进出口限制等方式增加贸易壁垒,公司可能面临无法和受限的上下游合作伙伴继续合作等风险,从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

(七)汇率波动风险

公司存在部分境外销售及境外采购的情况,并主要通过美元或日元进行结算。2019年度和2020年度,公司汇兑损失分别为1,225.59万元和2,975.41万元。未来若人民币与美元或美元与日元汇率发生大幅波动,可能导致公司产生较大的汇兑损益,引起公司利润水平的波动,对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2023年2月27日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕415号),同意公司首次公开发行股票(以下简称"本次发行")的注册申请。具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(三)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》([2023]85号文)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称为"颀中科技",证券代码为"688352";公司A股股本118,903.7288万股(每股面值1.00元),其中15,132.9051万股股票将于2023年4月20日起上市交易。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2023年4月20日

(三)股票简称:颀中科技,扩位简称为"颀中科技"

(四)股票代码:688352

(五)本次公开发行后的总股本:118,903.7288万股

(六)本次公开发行的股票数量:20,000.00万股,全部为公开发行新股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:15,132.9051万股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:103,770.8237万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:

本次公开发行股票数量为20,000.00万股,本次发行最终战略配售股数3,699.8345万股,占本次发行数量的18.50%。本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期
1	中信建投投资有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	6,000,000	3.00%	72,600,000.00	24个月
2	中信建投基金-颀中科技员工参与战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	9,923,966	4.96%	120,079,988.60	12个月
3	中兵投资管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,719,008	1.86%	44,999,996.80	12个月
4	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	9,090,909	4.55%	109,999,998.90	12个月
5	国华人寿保险股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	8,264,462	4.13%	99,999,990.20	12个月
合计			36,998,345	18.50%	447,679,974.50	-

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"之"一、重要承诺事项"之"(一)本次发行前股东所持股份的股份锁定及约束措施的承诺"。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"之"一、重要承诺事项"之"(一)本次发行前股东所持股份的股份锁定及约束措施的承诺"。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。

战略配售部分,参与科创板跟投的保荐人相关子公司中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。除参与科创板跟投的保荐人相关子公司之外的其他参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐人:中信建投证券股份有限公司

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项标准:"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元"。

(二)公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

公司本次公开发行20,000.00万股人民币普通股(A股),发行价格为12.10元/股,发行后公司总股本为118,903.7288万股,发行完成后的总市值为143.87亿元,大于人民币10亿元;2021年,公司实现营业收入132,034.14万元,归属于母公司所有者的净利润28,563.03万元(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据),满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称:合肥颀中科技股份有限公司

英文名称:Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd.

注册资本:98,903.7288万元

法定代表人:张莹

成立日期:2018年1月18日

整体变更为股份有限公司时间:2021年12月9日

公司住所:合肥市新站区综合保税区内

邮政编码:230011

电话号码:0512-88185678

传真号码:0512-62531071

互联网网址:http://www.chipmore.com.cn/

电子邮箱:irsm@chipmore.com.cn

信息披露和投资者关系负责部门:证券管理部

信息披露和投资者关系负责人:余成强(董事会秘书)

信息披露和投资者关系负责人联系电话:0512-88185678

经营范围:半导体及光电子、电源、无线射频类元器件的开发、生产、封装和测试;销售本公司所生产的产品并提供售后服务;从事本公司生产产品的相关原物料、零配件、机器设备的批发、进出口、转口贸易、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务(上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品,根据国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务,覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。凭借在集成电路先进封装行业多年的耕耘,公司在以凸块制造(Bumping)和覆晶封装(FC)为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位,形成了以显示驱动芯片封测业务为主,电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封测业务齐头并进的良好格局。

所属行业:根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)下属的集成电路制造业(C3973),具体细分行业为集成电路封装测试业。

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东

发行人控股股东为合肥颀中控股。本次发行前,合肥颀中控股持有公司40.15%的股份,持股比例超过30%,足以对公司的股东大会决议产生重大影响,系公司的控股股东。

合肥颀中控股的基本信息如下:

公司名称	合肥颀中科技控股有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2RLAL27R
类型	其他有限责任公司
注册地址	合肥市新站区大禹路98号合肥奕斯伟材料技术有限公司2层办公区
法定代表人	左长云
注册资本	170,001.00万元人民币
成立日期	2018年4月4日
营业期限	2018年4月4日至无固定期限
主营业务	控股型公司,无实际经营业务
经营状态	存续(在营、开业、在册)
与发行人主营业务关系	无

截至本上市公告书签署日,合肥颀中控股的股权结构如下:

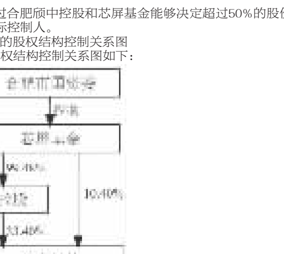
序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	合肥奕斯伟封测投资中心合伙企业(有限合伙)	170,000.00	99.9994
2	合肥奕斯伟投资有限公司	1.00	0.0006
合计		170,001.00	100.00

(二)实际控制人

本次发行前,合肥市国资委及其下属合肥建投通过合肥颀中控股和芯屏基金能够决定超过50%的股份表决权和超过半数的董事表决权,合肥市国资委系公司的实际控制人。

(三)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况

(一)董事

截至本上市公告书签署日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事由公司股东大会选举产生,任期三年。公司现任9名董事情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本持股比例(%)	持有债券情况	限售期限
1	张莹	董事长	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–
2	余卫珍	董事	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–
3	罗世蔚	董事	2021年12月9日-2024年12月8日	–	3.02	3.02	0.0031	–	自上市之日起锁定36个月
4	许靖	董事	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–
5	杨宗铭	董事、总经理、核心技术人员	2021年12月9日-2024年12月8日	–	305.08	305.08	0.3085	–	自取得股份之日起锁定36个月
6	余成强	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	2021年12月9日-2024年12月8日	–	251.24	251.24	0.2540	–	自取得股份之日起锁定36个月
7	胡晓林	独立董事	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–
8	崔也光	独立董事	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–
9	王新	独立董事	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–

注:1、间接持股数系各人员通过间接持股主体所持有的发行人股份,其计算方式为:间接持股数量=间接持股主体持有发行人的股份数量*各人员所持有间接持股主体的出资份额比例;上述持股数量未包括发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划,后同。

2、罗世蔚持有颀邦科技0.01%的股份,颀邦科技系公司股东颀中控股(香港)之股东,罗世蔚通过颀中控股(香港)间接持股3.02万股。

3、杨宗铭通过奕斯众志间接持股290.67万股,通过苏州融可源间接持股14.41万股,单项数据之和与合计数的差异系四舍五入所导致。

4、余成强通过奕斯众志间接持股251.24万股。

(二)监事

截至本上市公告书签署日,公司监事会由3名监事组成。股东代表出任的监事由股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事每届任期3年,任期届满连选可以连任。公司现任3名监事情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本持股比例(%)	持有债券情况	限售期限
1	左长云	监事会主席	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–
2	朱晓玲	监事	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–
3	胡雪妹	职工代表监事	2021年12月9日-2024年12月8日	–	–	–	–	–	–

(三)高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司共有高级管理人员5名。公司现任5名高级管理人员情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本持股比例(%)	持有债券情况	限售期限
1	杨宗铭	董事、总经理、核心技术人员	2021年12月9日-2024年12月8日	–	305.08	305.08	0.3085	–	自取得股份之日起锁定36个月
2	余成强	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	2021年12月9日-2024年12月8日	–	251.24	251.24	0.2540	–	自取得股份之日起锁定36个月
3	周小青	副总经理	2021年12月9日-2024年12月8日	–	135.17	135.17	0.1367	–	自取得股份之日起锁定36个月
4	李良松	副总经理	2021年12月9日-2024年12月8日	–	135.17	135.17	0.1367	–	自取得股份之日起锁定36个月
5	张玲玲	副总经理	2021年12月9日-2024年12月8日	–	38.84	38.84	0.0393	–	自取得股份之日起锁定36个月

注:1、周小青通过奕斯众志间接持股135.17万股。

2、李良松通过奕斯众志间接持股135.17万股。

3、张玲玲通过奕斯众志间接持股18.07万股,通过苏州融可源间接持股20.77万股,单项数据之和与合计数的差异系四舍五入所导致。

(四)核心技术人员

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员共4名,包括杨宗铭、梅嬿、王小锋、戴磊。

序号	姓名	职务	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本持股比例(%)	持有债券情况	限售期限
1	杨宗铭	董事、总经理	–	305.08	305.08	0.3085	–	自取得股份之日起锁定36个月
2	梅嬿	总监	–	128.52	128.52	0.1299	–	自取得股份之日起锁定36个月
3	王小锋	总监	–	118.86	118.86	0.1202	–	自取得股份之日起锁定36个月
4	戴磊	副总监	–	46.72	46.72	0.0472	–	自取得股份之日起锁定36个月

注:1、梅嬿通过奕斯众志间接持股128.52万股。

2、王小锋通过奕斯众志间接持股118.86万股。

3、戴磊通过奕斯众诚间接持股46.72万股。

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员均不存在直接持有公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日,公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书余成强之配偶郑云玲通过奕斯众志间接持股105.92万股,通过苏州融可源间接持股44.51万股,合计间接持股150.43万股,占发行前总股本比例为0.1521%,限售期限为自取得股份之日起锁定36个月。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"。

公司董事、高级管理人员、核心技术人员中的杨宗铭、余成强、周小青、李良松、张玲玲、梅嬿、戴磊和王小锋通过专项资产管理计划参与战略配售,具体情况详见"第三节发行人、实际控制人及股东持股情况"之"七、本次战略配售情况",参与战略配售的专项资产管理计划限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

(一)员工持股平台基本情况

截至本上市公告书签署日,发行人没有发行前制定上市后实施的员工期权计划。发行人所处行业为技术密集型行业,发行人需要通过股权激励等方式吸引优秀人才、增强团队凝聚力,保障公司未来持续发展,促进公司中长期战略目标达成。截至本上市公告书签署日,发行人共设立有奕斯众志、奕斯众诚和奕斯众力三个员工持股平台。

本次发行后,发行人员工持股平台奕斯众志、奕斯众诚和奕斯众力分别持有公司3,214.33万股、634.69万股和97.97万股,占上市前公司总股本的比例分别为3.25%、0.64%和0.10%。

(二)员工持股平台的人员构成

奕斯众志、奕斯众诚和奕斯众力的基本情况如下:

1、奕斯众志

截至本上市公告书签署日,奕斯众志基本情况如下:

企业名称	合肥奕斯众志科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MA2TFFWQ6T
企业类型	有限合伙企业
注册资本	8,016.06万元
执行事务合伙人	梅嬿
成立日期	2019-02-14
营业期限	2019-02-14至2069-02-13
注册地址	合肥市新站区大禹路98号合肥颀中材料技术有限公司2层办公区
经营范围	大规模集成电路产品和半导体专用材料的研发、生产、封装、测试;投资咨询;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本上市公告书签署日,奕斯众志的出资结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	游敦成	有限合伙人	773.71	9.65
2	杨宗铭	有限合伙人	724.88	9.04
3	余成强	有限合伙人	626.56	7.82
4	方祺俊	有限合伙人	519.88	6.49
5	杨适嘉	有限合伙人	511.93	6.39
6	林敬智	有限合伙人	498.64	6.22
7	郑子英	有限合伙人	467.28	5.83
8	李建民	有限合伙人	433.37	5.41
9	周小青	有限合伙人	337.08	4.21
10	李良松	有限合伙人	337.08	4.21
11	梅嬿	普通合伙人	320.53	4.00
12	王小锋	有限合伙人	296.41	3.70
13	郑云玲	有限合伙人	264.15	3.30
14	谢秀英	有限合伙人	253.54	3.16
15	张竹铭	有限合伙人	244.04	3.04
16	张纬龙	有限合伙人	242.10	3.02
17	赵晓东	有限合伙人	79.10	0.99
18	陈秀龙	有限合伙人	73.69	0.92
19	奚耀鑫	有限合伙人	73.25	0.91
20	周伟华	有限合伙人	68.46	0.85
21	陈浩	有限合伙人	61.49	0.77
22	许冠猛	有限合伙人	61.36	0.77
23	陈春燕	有限合伙人	60.89	0.76
24	张贤亮	有限合伙人	60.35	0.75
25	王媛媛	有限合伙人	58.48	0.73
26	鲁春健	有限合伙人	57.98	0.72
27	胡昆鹏	有限合伙人	55.87	0.70
28	李海	有限合伙人	55.61	0.69
29	王平	有限合伙人	52.58	0.66
30	张玲玲	有限合伙人	45.08	0.56
31	徐月娅	有限合伙人	44.08	0.55
32	刘晓辉	有限合伙人	42.89	0.54
33	韦丽平	有限合伙人	39.99	0.50
34	于良	有限合伙人	34.72	0.43
35	张华	有限合伙人	23.16	0.29
36	吴永江	有限合伙人	21.98	0.27
37	陆丹萍	有限合伙人	18.75	0.23
38	夏玉芳	有限合伙人	17.28	0.22
39	罗凯	有限合伙人	13.51	0.17
40	陈颖	有限合伙人	13.11	0.16
41	张云	有限合伙人	12.53	0.16
42	朱雅琴	有限合伙人	11.23	0.14
43	吴琼	有限合伙人	7.48	0.09
合计			8,016.06	100.00

2、奕斯众诚

截至本上市公告书签署日,奕斯众诚基本情况如下:

企业名称	合肥奕斯众诚科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MA2TU98F9T
企业类型	有限合伙企业
注册资本	1,583.64万元
执行事务合伙人	戴磊
成立日期	2019-06-24
营业期限	2019-06-24至2069-06-23
注册地址	合肥市新站区大禹路98号合肥颀材科技有限公司2层办公区
经营范围	大规模集成电路产品和半导体专用材料的研发、生产、封装、测试;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本上市公告书签署日,奕斯众诚的出资结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	戴磊	普通合伙人	116.57	7.36
2	戴志铨	有限合伙人	58.07	3.67
3	黄昕	有限合伙人	57.79	3.65
4	张金生	有限合伙人	57.71	3.64
5	许兵	有限合伙人	56.73	3.58
6	孙迪	有限合伙人	54.36	3.43
7	石浩	有限合伙人	54.05	3.41
8	陈镜先	有限合伙人	52.76	3.33
9	杨建华	有限合伙人	52.55	3.32
10	林杰	有限合伙人	51.34	3.24
11	顾建春	有限合伙人	50.32	3.18
12	许晓庆	有限合伙人	47.02	2.97
13	高峰	有限合伙人	44.89	2.83
14	倪军	有限合伙人	44.17	2.79
15	曹斌	有限合伙人	43.85	2.77
16	孙轶	有限合伙人	40.40	2.55
17	府晨华	有限合伙人	39.46	2.49
18	王聪丛	有限合伙人	39.35	2.48
19	祁峰	有限合伙人	39.24	2.48
20	Huang Sheng-Hsiung Tim	有限合伙人	39.14	2.47
21	黄家峰	有限合伙人	34.20	2.16
22	白惠	有限合伙人	32.73	2.07
23	钱波	有限合伙人	32.48	2.05
24	吕瑞忠	有限合伙人	32.29	2.04
25	梁怀臣	有限合伙人	31.80	2.01
26	吴涛	有限合伙人	27.79	1.75
27	谢浩	有限合伙人	27.41	1.73
28	汪江江	有限合伙人	26.42	1.67
29	孙文平	有限合伙人	26.05	1.65
30	何晓燕	有限合伙人	25.91	1.64
31	蔡文娟	有限合伙人	23.37	1.48
32	王江伟	有限合伙人	22.76	1.44
33	刘跃	有限合伙人	21.96	1.39
34	苏亮菊	有限合伙人	21.63	1.37
35	张昊	有限合伙人	21.37	1.35
36	薛剑	有限合伙人	20.58	1.30
37	洪俊	有限合伙人	18.30	1.16
38	张志锋	有限合伙人	18.06	1.14
39	游盛天	有限合伙人	17.10	1.08
40	秦凡生	有限合伙人	16.18	1.02
41	居晓君	有限合伙人	12.05	0.76
42	朱骎	有限合伙人	11.70	0.74
43	高琳	有限合伙人	11.06	0.70
44	王义栋	有限合伙人	10.69	0.67
合计			1,583.64	100.00

3、奕斯众力

截至本上市公告书签署日,奕斯众力基本情况如下:

企业名称	合肥奕斯众力科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MA2TU9BN3G
企业类型	有限合伙企业
注册资本	245.30万元
执行事务合伙人	宗超
成立日期	2019-06-24
营业期限	2019-06-24至2069-06-23
注册地址	合肥市新站区大禹路98号合肥颀中材料技术有限公司2层办公区
经营范围	大规模集成电路产品和半导体专用材料的研发、生产、封装、测试;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本上市公告书签署日,奕斯众力的出资结构如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	许志宾	有限合伙人	91.24	37.19
2	袁媛	有限合伙人	26.75	10.91
3	侯鑫悦	有限合伙人	20.03	8.17
4	钟金荣	有限合伙人	13.22	5.39
5	宗超	普通合伙人	11.69	4.76
6	成国飞	有限合伙人	10.69	4.36
7	施华枫	有限合伙人	10.69	4.36
8	杨解	有限合伙人	10.69	4.36
9	田江涛	有限合伙人	10.69	4.36
10	陈剑	有限合伙人	10.69	4.36
11	顾寅	有限合伙人	10.69	4.36
12	马耀中	有限合伙人	10.69	4.36
13	钱超	有限合伙人	7.55	3.08
合计			245.30	100.00

(三)持股平台的锁定安排

员工持股平台奕斯众志、奕斯众诚、奕斯众力承诺如下:

"若发行人首次公开发行股票并上市的申报于本次增资完成工商变更登记手续之日后12个月内完成,则自发行人本次增资完成工商变更登记手续之日起36个月之内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若发行人首次公开发行股票并上市的申报于本次增资完成工商变更登记手续之日起满12个月后完成,则自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

如果本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容,则由此所得的收益归发行人。本企业在接到发行人董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给发行人。"

五、本次发行前后的股本结构变动情况

公司发行前总股本为98,903.7288万股,本次公开发行人民币普通股20,000.00万股,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

本次发行前后公司的股本结构变动情况如下:

序号	股东名称	发行前 股数(股)	发行前 比例(%)	发行后 股数(股)	发行后 比例(%)	限售期
一、限售流通股						
1	合肥颀中控股(CS)	397,127,159	40.15	397,127,159	33.40	自上市之日起锁定36个月
2	颀中控股(香港)	302,389,708	30.57	302,389,708	25.43	自上市之日起锁定36个月
3	芯屏基金	123,639,298	12.50	123,639,298	10.40	自上市之日起锁定36个月
4	CTC	34,398,078	3.48	34,398,078	2.89	自上市之日起锁定12个月
5	奕斯众志	32,143,301	3.25	32,143,301	2.70	自取得股份之日起锁定36个月
6	徐瑛	18,367,834	1.86	18,367,834	1.54	自取得股份之日起锁定36个月
7	芯动能基金	17,835,281	1.80	17,835,281	1.50	自上市之日起锁定12个月
8	中信投资	7,064,551	0.71	7,064,551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
9	日出投资	7,064,551	0.71	7,064,551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
10	中青芯鑫	7,064,551	0.71	7,064,551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
11	珠海华金领翊	6,358,096	0.64	6,358,096	0.53	自取得股份之日起锁定36个月
12	奕斯众诚	6,346,949	0.64	6,346,949	0.53	自取得股份之日起锁定36个月
13	青岛初芯海屏	5,651,641	0.57	5,651,641	0.48	自取得股份之日起锁定36个月
14	苏州融可源	4,945,186	0.50	4,945,186	0.42	自取得股份之日起锁定36个月
15	泉州常弘星越	4,238,731	0.43	4,238,731	0.36	自取得股份之日起锁定36个月
16	宁波诚池	4,238,731	0.43	4,238,731	0.36	自取得股份之日起锁定36个月
17	海宁艾克斯	2,825,821	0.29	2,825,821	0.24	自取得股份之日起锁定36个月
18	庄丽	2,825,821	0.29	2,825,821	0.24	自取得股份之日起锁定36个月
19	山南置立方	2,825,821	0.29	2,825,821	0.24	自取得股份之日起锁定36个月
20	奕斯众力	979,724	0.10	979,724	0.08	自取得股份之日起锁定36个月
21	珠海华金丰盈	706,455	0.07	706,455	0.06	自取得股份之日起锁定36个月
22	中信建投投资	–	–	6,000,000	0.50	自上市之日起锁定24个月
23	高管核心员工资管计划	–	–	9,923,966	0.83	自上市之日起锁定12个月
24	中兵投资管理有限公司	–	–	3,719,008	0.31	自上市之日起锁定12个月
25	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	–	–	9,090,909	0.76	自上市之日起锁定12个月
26	国华人寿保险股份有限公司	–	–	8,264,462	0.70	自上市之日起锁定12个月
27	部分网下限售股份	–	–	11,672,604	0.98	自上市之日起锁定6个月
小计		989,037,288	100.00	1,037,708,237	87.27	–
二、无限售流通股						
28	无限售条件流通股	–	–	151,329,051	12.73	无限售期
小计		–	–	151,329,051	12.73	–
合计		989,037,288	100.00	1,189,037,288	100.00	–

注:根据《上市公司国有股权监督管理办法》,合肥颀中控股证券账户标注为"CS"。部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。

六、本次发行后持股数量前十名股东的持股情况

本次发行后、上市前,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	合肥颀中控股(CS)	397,127,159	33.40	自上市之日起锁定36个月
2	颀中控股(香港)	302,389,708	25.43	自上市之日起锁定36个月
3	芯屏基金	123,639,298	10.40	自上市之日起锁定36个月
4	CTC	34,398,078	2.89	自上市之日起锁定12个月
5	奕斯众志	32,143,301	2.70	自取得股份之日起锁定36个月
6	徐瑛	18,367,834	1.54	自取得股份之日起锁定36个月
7	芯动能基金	17,835,281	1.50	自上市之日起锁定12个月
8	中信投资	7,064,551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
9	日出投资	7,064,551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
10	中青芯鑫	7,064,551	0.59	自取得股份之日起锁定36个月
合计		94,7,094,312	79.63	–

七、本次战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

1、参与跟投的保荐人相关子公司:中信建投投资有限公司

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(以下简称"员工资产管理计划"):中信建投基金-颀中科技员工参与战略配售集合资产管理计划;

3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业:中兵投资管理有限公司。

4、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业:中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国华人寿保险股份有限公司。

最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期
1	中信建投投资有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	6,000,000	3.00%	72,600,000.00	24个月
2	中信建投基金-颀中科技员工参与战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	9,923,966	4.96%	120,079,988.60	12个月
3	中兵投资管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,719,008	1.86%	44,999,996.80	12个月
4	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	9,090,909	4.55%	109,999,998.90	12个月
5	国华人寿保险股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	8,264,462	4.13%	99,999,990.20	12个月
合计			36,998,345	18.50%	447,679,974.50	–

(一)保荐人子公司跟投情况

1、跟投主体

中信建投证券按照《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》(以下简称"管理办法")《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(以下简称"实施细则")及《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为保荐人中信建投证券依法设立的全资子公司中信建投投资有限公司(简称"中信建投投资")。

2、跟投数量

中信建投投资的跟投比例为本次公开发行股票数量的3%,跟投股数6,000,000股,跟投金额72,600,000.00元。

3、限售期限

中信建投投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(二)发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建投基金-颀中科技员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称"颀中科技员工专项资管计划")。发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为9,923,966股,获配金额为120,079,988.60元。

1、基本情况

颀中科技员工专项资管计划的基本信息如下:

产品名称	中信建投基金-颀中科技员工参与战略配售集合资产管理计划
产品编码	SZK080
管理人名称	中信建投基金管理有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司合肥分行
备案日期	2023年2月16日
成立日期	2023年2月13日
到期日	2028年2月14日
投资类型	权益类
募集资金规模	12,008.00万元

颀中科技员工专项资管计划拟参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行数量的10%,即2,000.00万股。

2、实际支配主体

根据《资产管理合同》,管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用资产管理计划财产,按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。因此,颀中科技员工专项资管计划的管理人中信建投基金管理有限公司为颀中科技员工专项资管计划的实际支配主体。

3、董事会审议情况及人员构成

2023年1月31日,发行人召开第一届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司员工战略配售相关事宜的议案》。颀中科技员工专项资管计划参与人员、职务、认购金额及比例情况如下:

序号	姓名	职位	高级管理人员/核心员工	实缴金额(万元)	资管计划持有比例
1	杨宗铭	总经理	高级管理人员	1,870.00	15.57%
2	余成强	副总经理、董事会秘书、财务总监	高级管理人员	1,295.00	10.78%
3	周小青	副总经理	高级管理人员	1,135.00	9.45%
4	李良松	副总经理	高级管理人员	1,210.00	10.08%
5	张玲玲	副总经理	高级管理人员	1,200.00	9.99%
6	戴磊	副总监	核心员工	745.00	6.20%
7	梅嬿	总监	核心员工	357.00	2.97%
8	王小锋	总监	核心员工	798.00	6.65%
9	方祺俊	总监	核心员工	320.00	2.66%
10	黄昕	助理总监	核心员工	680.00	5.66%
11	李海	助理总监	核心员工	538.00	4.48%
12	李建民	总监	核心员工	435.00	3.62%
13	林敬智	总监	核心员工	180.00	1.50%
14	王平	副总监	核心员工	630.00	5.25%
15	杨适嘉	资深总监	核心员工	317.00	2.64%
16	赵晓东	副总监	核心员工	298.00	2.48%
合计				12,008.00	100.00%

颀中科技员工专项资管计划的参与人员均与发行人及其子公司签署了劳动合同,均为发行人的高级管理人员与核心员工。

4、限售期限

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺获得本次配售的证券限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(三)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业

中兵投资管理有限公司系与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。截至本上市公告书签署日,中兵投资管理有限公司的基本信息如下:

公司名称	中兵投资管理有限责任公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110000095357036N
住所	北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室
法定代表人	史艳晓
注册资本	100,000万元人民币
成立日期	2014-03-18
经营期限	2014-03-18至无固定期限
经营范围	投资管理;资产管理;项目投资;经济信息咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(下转A15版)

合肥颀中科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"本公司")发行的人民币普通股股票将于2023年4月20日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网:https://www.cs.com.cn/;中国证券网:https://www.cnstock.com/;证券时报网:https://www.stcn.com/;证券日报网:http://www.zqrb.cn/;经济参考网:http://www.jjckb.cn/),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:颀中科技

(二)扩位简称:颀中科技

(三)股票代码:688352

(四)首次公开发行后总股本:118,903.7288万股

(五)首次公开发行股票数量:20,000.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为118,903.7288万股,上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,参与战略配售的其他战略投资者本次获配股票的限售期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为15,132.9051万股,占发行后总股本的比例为12.73%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2023年4月3日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为30.30倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应2021年的静态市盈率(扣非前)	对应2021年的静态市盈率(扣非后)
002156.SZ	通富微电	0.6322	0.5262	22.77	36.02	43.28
603005.SH	晶方科技	0.8819	0.7215	25.54	28.96	35.40
688135.SH	利扬芯片	0.7712	0.6679	35.67	46.25	53.41
688216.SH	气派科技	1.2665	1.1894	31.35	24.75	26.36
688403.SH	汇成股份	0.1681	0.1125	13.95	83.00	123.99
均值					43.80	56.49

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年4月3日(T-3日)。

注1:2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年4月3日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格12.10元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为50.37倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2021年扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一)发行人:合肥颀中科技股份有限公司		
	法定代表人:	张莹
	联系地址:	合肥市新站区综合保税区内
	联系电话:	0512-88185678
	传真:	0512-62531071
	联系人:	余成强
(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司		
	法定代表人:	王常青
	联系地址:	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	联系电话:	021-6880 1584
	传真:	021-6880 1551
	保荐代表人:	吴建航、曹显达

合肥颀中科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
2023年4月19日